

事業概要

Hirataは1951年の創立以来、自動車、半導体、家電などさまざまな産業分野の生産システムを製造・販売してきました。

お客さまの課題解決に貢献するさまざまなタイプの生産システムを提供するとともに、環境配慮型製品や医療・理化学機器など事業領域の拡大にも取り組んでいます。

売上高

828億39百万円

前年度比5.6%増

営業利益

60億47百万円

前年度比2.2%増

総資産

1,307億87百万円

45%

33%

19%

3%



自動車関連事業

EV(電気自動車)関連、エンジン、トランスミッション、部品関連などの設備に一括して対応。デジタル技術を活用した事前検証や当社工場での総合試運転などにより、最適化したソリューションを提供。EV関連を中心に、北米自動車メーカー(ビッグスリー)・北米新興EVメーカー・国内電子部品メーカーから継続受注。

売上高

369億84百万円

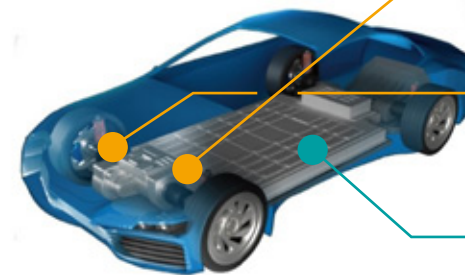
営業利益

16億51百万円

営業利益率

4.5%

EV関連の主力・拡大分野



主力分野 EDU組立設備

EDU(Electric Drive Unit)と呼ばれる車載用のモータとギアボックスを組み合わせた、EVの駆動用部品の組立設備を製造

主力分野 IGBT・インバーター組立設備

IGBTやインバーターといった、EVに搭載される車載用電子部品の組立設備を製造

拡大分野 バッテリー関連設備(セル充放電工程)

バッテリーのセル工程の一部である充放電工程の搬送設備を製造



半導体関連事業

シリコンウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、大気・真空環境に対応可能なウェーハ搬送ロボット、アライナ、それらを統合したEFEMおよび真空プラットフォームなどを製造・販売。国内製造装置メーカー向けのウェーハ搬送装置や検査装置間のハンドリング装置を中心に継続受注。

売上高

273億90百万円

営業利益

44億50百万円

営業利益率

16.2%

半導体製造工程

設計

回路・パターン設計
フォトマスク作成

前工程

ウェーハの作成
回路/パターン作成
・ウェーハ表面の酸化
・薄膜形成
・フォトマスクの
パターン転写
・イオン注入

後工程

ダイシング
ダイボンディング
ワイヤーボンディング
パッケージング
製品化と最終検査

主力分野 ウェーハ搬送装置

シリコンウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、大気・真空環境に対応可能なウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEMを製造

主力分野 検査装置間の搬送装置

完成したICチップを検査装置や別のトレイに運搬・移載するハンドリング装置などを製造

拡大分野 PLP*

* Panel Level Packaging

PLP工程などに使用される、パネル基盤搬送用のEFEM・ロードポート・ウェーハ搬送ロボットやパネル製造用の搬送設備を製造



その他自動省力機器事業

医療・理化学機器、家電、産業用ロボット、物流(搬送システム)、FPDの分野で自動省力機器を製造・販売。FA機器単品販売にも対応。

国内製造装置メーカー向けの有機EL用蒸着装置や医療・理化学機器、アジア家電製造メーカー向けの組立設備を継続受注。

売上高

160億83百万円

営業利益

1億19百万円

営業利益率

0.7%

主力分野 医療理化学機器

検体検査用の装置(病理組織標本作製装置や全自動連続薄切装置)を製造

主力分野 家電メーカー向け組立設備

高性能家電に組み込まれるモータの組立設備をはじめ、あらゆる設備・装置を製造

継続分野 有機EL用蒸着装置

有機EL/パネル用の真空蒸着装置の製造を受託

拡大分野 エコ電動シリーズ

エア機器不要で持続可能なものづくりを推進するHirataのオール電動搬送システム。自社開発のブラシレスDCモータにより、生産システムの省力化、コンパクト化を実現

(注)上記3セグメントに含まれない事業は「その他」として計上しています。